

臻鼎

成立于2006年，集设计、研发、制造、销售提供各类印刷电路板产品的一站式、多方位解决方案的事业服务公司，广泛应用到多个终端产品

品牌简介

臻鼎科技控股股份有限公司成立于2006年，主要提供各类印刷电路板产品(软性电路板、类载板、高密度连接板、硬质电路板、IC载板、软硬结合板、覆晶薄膜、模组)设计、研发、制造、销售等一站式、多方位解决方案的事业服务公司。

配合5G、AI、物联网、车联网等应用不断推陈出新，积极发展包含：软性电路板(FPC)、类载板(SLP)、高密度连接板(HDI)、硬质印刷电路板(RPCB)、IC载板(ICS)、软硬结合板(RigidFlex)、覆晶薄膜(COF)、模组产品(Module)及半导体相关的先进技术产品，广泛应用于智慧型手机、网路设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记型电脑、伺服器、基地台、智慧家电、汽车及医疗设备等终端产品上。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/zd-632172.html>